

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

498

ML4

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

29.07.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	315		2
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		3
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		4
C-RS-FR4-DS-2.40mm-035+035-TG150-HF	50200991	35	L2	5
		2330		
		35	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	315		6
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		7
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		8
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	RS	9

Dicke nach Verpressen

B00:

3090 µm

Tol+:

320 µm

Tol-:

320 µm

Dmax:

3410 µm

Dmin:

2770 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

3200 µm

Tol+:

320 µm

Tol-:

320 µm

Dmax:

3520 µm

Dmin:

2880 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

3100 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik